

機台名稱：	C2W 晶片對準接合機
機台編號：	SE-024
制訂部門：	異質整合製程組
制訂日期：	2021/10/15

一、目的： 定義 C2W 晶片對準接合機操作規範，以確保操作品質。

二、範圍：適用於 C2W 晶片對準接合機。

三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。

2. 執行人員資格：經過 C2W 晶片對準接合機考核通過之人員。

四、名詞定義：無。

五、 相關文件：無。

六、標準作業程序：



#### (一)操作流程:

1. 機台刷卡開機登入。
2. 確認製程程式已開啟。
3. 選取適當吸嘴頭並更換鎖緊。
4. 將 chip 接合面朝下擺放於 bottom 適當的平台位置上。
5. 選取建立好的參數名稱，先執行 pick up 將試片吸取至吸頭上。
6. 接著將 substrate 接合面朝上擺放於 bottom 適當的平台位置上。
7. 接著執行 manual align 將試片與基板對準。
8. 最後執行 bonding 條件製程，待製程結束後將接合好的一對試片取走。
9. 機台刷卡登出。

#### (二)注意事項:

1. 若無適當吸嘴頭需自行訂製備妥後方能使用。
  2. 特殊製程需機台負責人討論後方可進行。
-